

8412 ACF

製品案内



異方導電性 熱活性接着テープ

製品の説明

テサ8412ACFは異方導電性を持つ熱活性接着フィルムで、導電性粒子を主成分である反応型フェノール樹脂とニトリルゴムに混合した製品です。

- フィルムの厚み方向への導電性を有する。
- 1工程でモジュールの機械的接合と電気的な導通の両方が可能。
- 従来の接触型の実装機で作業が可能（スマートカード製造の場合）。
- PVC、ABS、PET、PCの樹脂カード及び金属、アルミに適用可能。
- 耐候性に優れる。

特徴

- Excellent grounding performance in applications with structural bonding requirements
- High bonding strength in narrow and small bonding areas
- Good ageing resistance
- Reliable SmartCard chip bonding and electrical connectivity in one step
- Suitable for PVC, ABS and PC SmartCards (DI)

用途

- PVC、ABSカードに（DI）

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	無し	• 総厚	50 µm
• 粘着剤	ニトリルゴム・フェノール樹脂混合物	• 色	琥珀色
• ライナー	グラシン		

特性 / 性能

• 接着強度	4 N/mm ²	• 熱圧着温度	120 °C
• 接触抵抗 z方向	200 mOhm		

備考

Technical Recommendations:

The following values are recommendation for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip-modules as well as customer requirements.

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08412>



8412 ACF

製品案内

備考

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. This step can be performed inline or offline. The pre-lamination step does not effect the shelf life time of the adhesive tape.

Machine setting:

- Temperature 130 - 140 °C
- Pressure 2 - 3 bar
- Time 2.5 m/min

2. Module Embedding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. For this step, the exact handling depends on the type of the implanting line used. Single step and multiple step can be used. Today, multiple step is common:

Single step process - Machine setting :

- Temperature¹ 180 – 220 °C
- Pressure 65 N/module
- Time 1.5 s

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

- Temperature¹ 180 – 220 °C
- Pressure 65 N/module
- Time 2 x 0,7 s. /3 x 0.5 s

¹ Temperature as measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

*PVC 180 - 190 °C

*ABS 180 - 190 °C

*PET 190 - 200 °C

*PC 200 - 220°C

For applicants other than chip module implanting, different machine parameters should be used.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. Value is guaranteed clearance limit checked with each production batch (Material: Etched aluminium test specimen / Bonding conditions: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min)

Storage conditions according to tesa® HAF shelf life concept.



8412 ACF

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08412>